



## VIA Technologies, Inc.

531 Zhongzheng Road, 1F | Xindian Dist, New Taipei City 231 | Taiwan  
Tel: +886-2-2218-1838 | Fax: +886-2-2218-8924 | [www.viatech.com](http://www.viatech.com)

### VIA、Qualcomm® Snapdragon™ 820E エンベデッドプラットフォーム搭載 VIA エッジ AI 開発キットを発表

2018年5月11日 台湾・新北市 - VIA Technologies, Inc.は、日本時間の5月10日、Japan IT Week 春・IoT/M2M 展において、インテリジェントなエッジ AI システムおよびデバイスの設計、テストおよび展開を簡素化する Qualcomm® Snapdragon™ 820E エンベデッドプラットフォームを搭載した高度に統合されたパッケージである VIA エッジ AI 開発キットを発表し、サンプル出荷を開始いたしました。



本キットは、VIA SOM-9X20 SOM モジュールと SOMDB2 キャリアボード、インテリジェントなリアルタイムのビデオキャプチャ、プロセッシングおよびエッジ解析に最適化された 13MP カメラモジュールを組み合わせています。エッジ AI アプリケーションの開発は Snapdragon Neural Processing Engine (NPE) のサポートと、AI アプリケーションを駆動する Qualcomm® Hexagon™ DSP、Qualcomm® Adreno™ 530 GPU、または Qualcomm® Kryo™ CPU のフルアクセラレーションをに対応した Android 8.0 BSP によって可能になります。また、Yocto 2.0.3 に基づく Linux BSP は、今年 6 月にリリース予定です。

「VIA AI エッジ開発キットは、次世代エッジ AI システムおよびデバイスの設計、テストおよび導入のコストと複雑さを軽減します」と、VIA Technologies, Inc.の国際マーケティング担当 VP であるリチャード・ブラウンは次のように述べています。「本キットは、コアハードウェアとソフトウェアコンポーネントを 1 つのパッケージにまとめることで、数多くのスマートカメラ、スマートサイネージ、インタラクティブキオスク、インテリジェントロボットシステムやデバイスのための顔認証やオブジェクト検出など、さまざまな機能を備えたビデオ AI アプリケーションの開発と最適化を実現します」

### 発売時期と価格

VIA エッジ AI 開発キットは、VIA Embedded オンライнстアを通じて、次の構成で発売中です。

- VIA SOM-9X20 SOM モジュール、SOMDB2 キャリアボード  
および 13MP CMOS カメラモジュール(COB1/3.06" 4224 × 3136 ピクセル) : 629 ドル(送料別)
- VIA SOM-9X20 SOM モジュールと SOMDB2 キャリアボード : 569 ドル(送料別)
- オプションの 10.1 インチ MIPI LCD タッチパネル : 179 ドル(送料別)

また、VIA は、システムの商用化を加速し、開発コストを最小限に抑えるハードウェアとソフトウェアのカスタマイズサービスを提供するほか、フルターンキー開発サービスも利用いただけます。

### VIA SOM-9X20

VIA SOM-9X20 は、Qualcomm の Snapdragon 820E エンベデッドプラットフォームを搭載した高度に統合されたシステム・オン・モジュール(SOM)です。本モジュールは、わずか 8.2 × 4.5cm のサイズで、64GB eMMC フラッシュメモリと 4GB LPDDR4 SDRAM を搭載し、MXM 3.0 314 ピンコネクタを介して USB 2.0、HDMI 2.0、SDIO PCIe、MIPI CSI、MIPI DSI、UART 用多機能ピン、I2C、SPI、GPIO などの豊富な I/O とディスプレイ拡張オプションを提供します。

VIA SOM-9X20 の詳細については、次の URL を参照してください。

<https://www.viatech.com/en/boards/modules/som-9x20/>

このリリースに関連する画像については、<https://www.viagallery.com/som-9x20/> をご覧ください。

### VIA Technologies, Inc.について

VIA Technologies, Inc.は、高度に統合された組み込み用プラットホームと、ビデオウォールやデジタル看板からヘルスケアや企業オートメーションまでにわたる M2M、IoT、そしてスマートシティアプリケーションの開発において国際的に主導的な役割を果たしています。本社を台湾・台北におき、VIA の国際的なネットワークはアメリカ、ヨーロッパ、そしてアジアのハイテクセンターを結び、顧客層は世界中の最先端のハイテク、通信、家電にまでわたっています。詳しくはこちらをご覧ください。

<http://www.viatech.com/>

### お客様からのお問い合わせ先

VIA Technologies Japan 株式会社

メールアドレス: [mktjp@viatech.co.jp](mailto:mktjp@viatech.co.jp)

### 本件に関する報道関係者からのお問い合わせ

Richard Brown (VIA Technologies, Inc. 国際マーケティング担当 VP)

メールアドレス: [RIBrown@via.com.tw](mailto:RIBrown@via.com.tw)

HaNaRe PR Group (VIA Technologies, Inc. 日本広報代理)

メールアドレス: [press@hanare-pr.jp](mailto:press@hanare-pr.jp)

記者ならびに編集の方々へお願い: VIA はすべて大文字で表記してください。